(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2011 年 6 月 23 日(23.06.2011)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2011/074520 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/56 (2006.01) *H01L 23/12* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2010/072341

(22) 国際出願日: 2010 年 12 月 13 日(13.12.2010)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2009-282818 2009 年 12 月 14 日(14.12.2009) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社(SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川二丁目５番８号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 楠木 淳也(KUSUNOKI Junya) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川二丁目５番８号住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 竹内 江津(TAKEUCHI Etsu) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川二丁目５番８号住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 杉山 広道(SUGIYAMA Hiromichi) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川二丁目５番８号住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 久保山 俊治(KUBOYAMA Toshiharu) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川二丁目５番８号住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 川田 政和(KAWATA Masakazu) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川二丁目５番８号住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 二階堂 広基(NIKAIDO Hiroki) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川二丁目５番８号住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 前田 将克(MAEDA Masakatsu) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川二丁目５番８号住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 赤塚 賢次, 外(AKATSUKA Kenji et al.); 〒1010041 東京都千代田区神田須田町１－１６本郷ビル５階 Tokyo (JP).

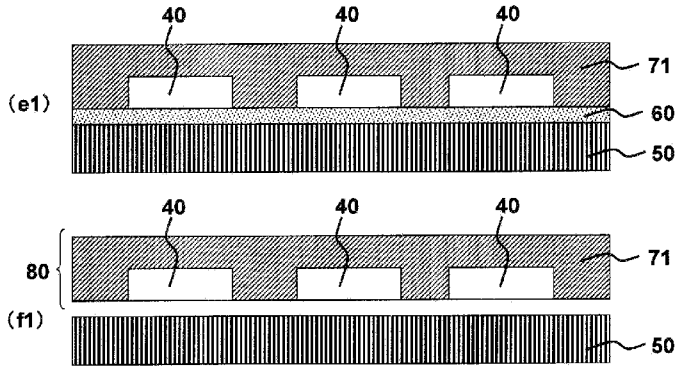
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,

[続葉有]

(54) **Title**: METHOD FOR PRODUCING ELECTRONIC DEVICE, ELECTRONIC DEVICE, METHOD FOR PRODUCING ELECTRONIC DEVICE PACKAGE, AND ELECTRONIC DEVICE PACKAGE

(54) 発明の名称 : 電子装置の製造方法、電子装置、電子装置パッケージの製造方法および電子装置パッケージ

[図3]



(57) **Abstract**: Disclosed is a method for producing an electronic device, comprising: a fixing resin layer forming step for providing a fixing resin layer on a surface of a support substrate; an electronic component fixing step for disposing multiple electronic components on the fixing resin layer such that a space is formed between adjacent electronic components, and fixing the electronic components to the support substrate via the fixing resin layer; a sealing component forming step for covering the electronic components with a sealing component to thereby form a sealing component layer on the fixing resin layer and on the electronic component; a sealing component curing step for curing the sealing component by heating to thereby obtain a cured sealing component which is supported on the support substrate and on which the electronic components are disposed; and a removing step for removing from the support substrate the cured sealing component which is supported on the support substrate and on which the electronic components are disposed, wherein in the removing step, resin contained in the fixing resin layer is changed into a low-molecular-weight substance to thereby remove the cured sealing component from the support substrate.

(57) 要約:

[続葉有]

WO 2011/074520 A1